

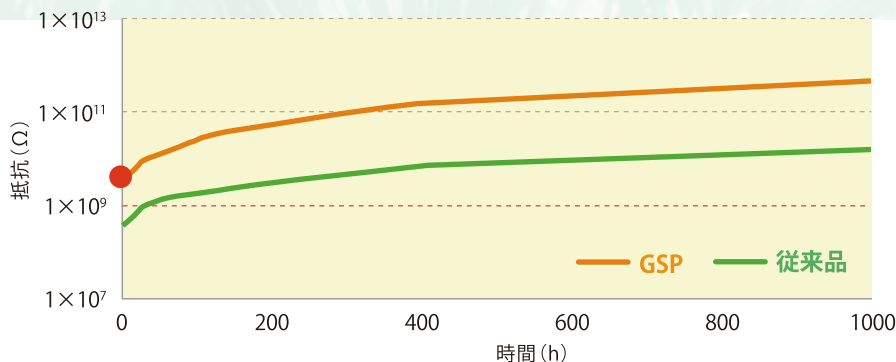
自動車用鉛フリースタンダードソルダペースト

高い信頼と実績 トヨタ自動車(株)様で採用

GSP

高い絶縁抵抗値

絶縁抵抗値



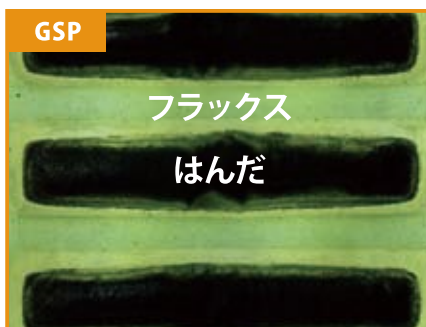
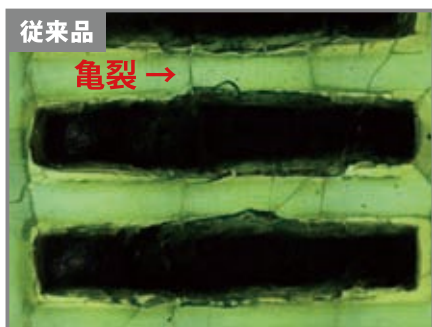
評価条件

- 試験基板: JIS II 型基板
- 印刷厚: 150 μm
- 印可電圧: 20V
- 環境: 85°C / 85%RH

初期から $1 \times 10^9 \Omega$ をキープ

残渣亀裂の抑制を実現

残渣亀裂 (冷熱サイクル)



評価条件

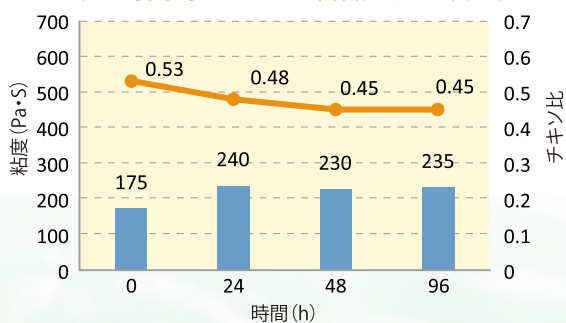
- 冷熱条件: -40 ⇄ 125°C 各30分
- 観察箇所: 0.5mm QFP部
- 印刷厚: 180 μm
- 基板裏面からライトを当て、透過観察を実施。

2,000サイクル : フラックス部に亀裂なし

優れた粘度安定性

粘度とチキン比の変化

〈12時間毎に80%を新品と入れ替え〉



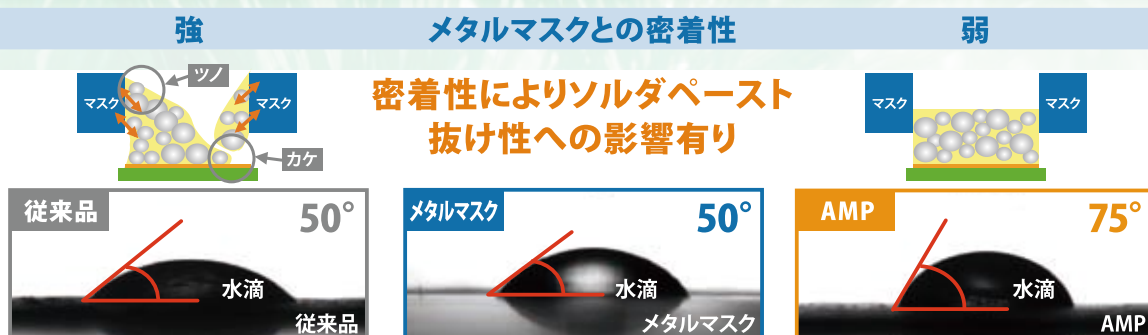
優れた粘度安定性 ▶
「ペースト廃棄量の削減」が可能

高信頼性自動車用鉛フリーソルダペースト

通常マスク厚で微細印刷が可能に

AMP

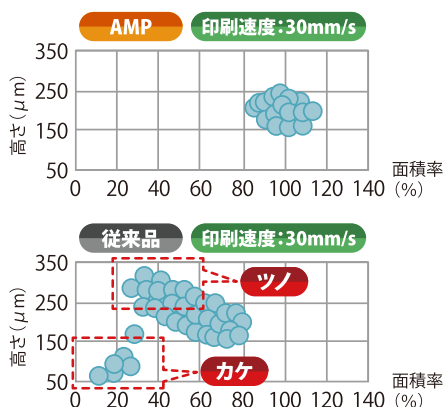
撥水性を高めた合成樹脂を新規開発



- ・メタルマスク開口部との摩擦軽減 ▶ 微細印刷が向上
- ・撥水性の付与 ▶ 電気信頼性の向上

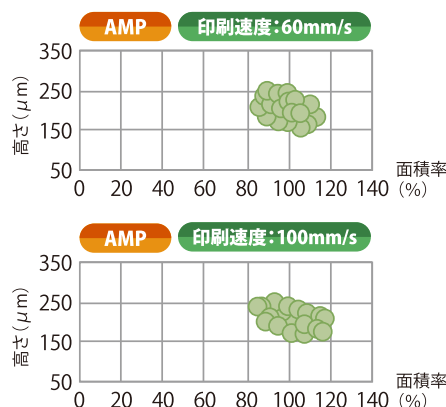
安定した微細印刷性

優れた微細印刷性



新開発樹脂の適用 ▶
優れた微細印刷性を実現

優れた高速印刷性



安定した印刷が可能 ▶
製造時間の短縮が可能

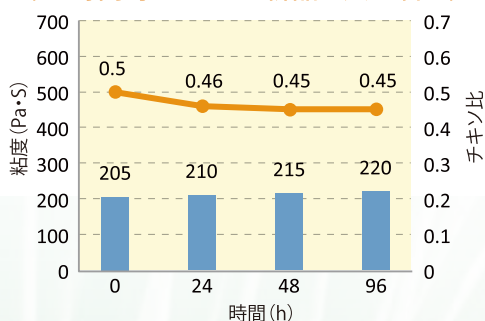
評価条件

- 開口部: 275µmΦ部分
- 印刷厚: 150µm

優れた粘度安定性

粘度とチキソ比の変化

〈12時間毎に80%を新品と入れ替え〉



0.4mm QFP部

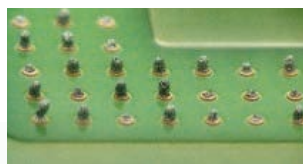


従来品

AMP

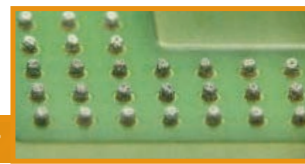


0.5mm BGA部



従来品

AMP



厚み150µm厚で0.4mmQFP、0.5mmBGA実装が可能